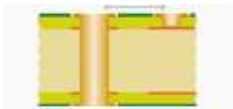




## PARÁMETROS DE FABRICACIÓN MULTICAPA

		CLASE 3	CLASE 4	CLASE 5	CLASE 6	CLASE 7
Diámetro mínimo taladro metalizado		0,50 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,20 mm	0,15 mm
Diámetro mínimo taladro NO metalizado		0,60 mm	0,40 mm	0,40 mm	0,30 mm	0,25 mm
Aspect / Ratio (grosor circuito / taladro mínimo)		5	5	6	8	13 (grosor máximo de 2 mm)
Ancho / espacio mínimo conductor en capas externas (grosor cobre base)		0,30 mm (17 μm) 0,30 mm (35 μm) 0,35 mm (70 μm)	0,20 mm (17 μm) 0,20 mm (35 μm) 0,25 mm (70 μm)	0,15 mm (17 μm) 0,15 mm (35 μm) 0,20 mm (70 μm)	0,125 mm (17 μm) 0,15 mm (35 μm) 0,175 mm (70 μm)	0,100 mm (17 μm)
Ancho / espacio mínimo conductor en capas internas (grosor cobre base)		0,25 mm (17 μm) 0,30 mm (35 μm) 0,30 mm (70 μm)	0,15 mm (17 μm) 0,20 mm (35 μm) 0,20 mm (70 μm)	0,125 mm (17 μm) 0,15 mm (35 μm) 0,175 mm (70 μm)	0,10 mm (17 μm) 0,125 mm (35 μm) 0,15 mm (70 μm)	0,075 mm (17 μm) 0,100 mm (35 μm)
Corona mínima en capas externas		0.22 mm	0.17 mm	0.13 mm	0.10 mm	0.075 mm
Corona mínima en capas internas de señal		0.25 mm	0.22 mm	0.19 mm	0.15 mm	0.125 mm
Aislamiento mínimo entre taladro metalizado y conductor		0.40 mm	0.40 mm	0.30 mm	0.25 mm	0.20 mm
Diámetro mínimo microvía				0,10 mm (grosor aislante máximo 0.1 mm)	0,075 mm (grosor aislante máximo 0.065 mm)	0,075 mm (grosor aislante máximo 0.065 mm)
Pad superior microvía				0.35 mm	0.30 mm	0.25 mm
Pad inferior microvía				0.30 mm	0.25 mm	0.25 mm
Pared mínima entre microvía y				0.22 mm	0.15 mm	0.10 mm

taladro  
pasante /  
ciego /  
enterrado



Pared  
mínima  
entre  
microvías



Pared  
mínima  
entre  
microvías a  
2 niveles



0.23 mm	0.15 mm	0.10 mm
---------	---------	---------

0.23 mm	0.15 mm	0.10 mm
---------	---------	---------

Última actualización: 13-02-2012  
Unidades: Milímetros